

06.3;07;12

**ШИРОКОАПЕРТУРНЫЙ  
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОТОДЕТЕКТОР  
НА ОСНОВЕ СПИРАЛЬНОЙ  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК-МЕТАЛЛ**

© Н.М.Ушаков, В.И.Петросян

В системах оптической обработки информации и связи фотодетекторы на основе встречно-штыревых структур металл-полупроводник-металл с барьером Шоттки-Бардина занимают одно из важных мест. Это обусловлено тем, что такие фотодетекторы обеспечивают высокое быстродействие с одновременным сохранением относительно высокой чувствительности [<sup>1,2</sup>], а также хорошо интегрируются с различными элементами оптических интегральных схем [<sup>3</sup>]. Для линейной кинетики фототока время нарастания (или спада) импульса фототока определяется как сумма пролетного времени и времени схемной релаксации. При этом оптимальным является случай, когда время схемной релаксации не превышает пролетного времени основных носителей тока в структуре [<sup>4</sup>]. Современная технология литографии позволяет обеспечивать межэлектродные зазоры субмикронных размеров и тем самым обеспечить малые (порядка единиц пикосекунд и менее) времена пролета носителей тока. Уменьшение времени схемной релаксации связано со значительным уменьшением апертуры фотодетектора, что в свою очередь создает проблемы юстировки и приема оптических сигналов. Предлагаемый фотодетектор на основе планарной спиральной структуры позволяет избежать этого недостатка. Апертура фотодетектора может быть увеличена примерно в четыре раза по сравнению с встречно-штыревой структурой без уменьшения быстродействия. Металлическая структура электродов в таком фотодетекторе выполнена в виде плоской двухзаходной спирали, состоящей из двух частей с односторонним ходом витков, причем концы частей спирали в центре ее электрически разомкнуты [<sup>5</sup>]. Общий вид такой спиральной структуры изображен на рис. 1, а, б.

На полупроводниковую подложку 1 нанесен слаболегированный эпитаксиальный слой 2, на поверхности которого сформирована металлическая структура спирального типа в виде "улитки". Она состоит из двух электрически

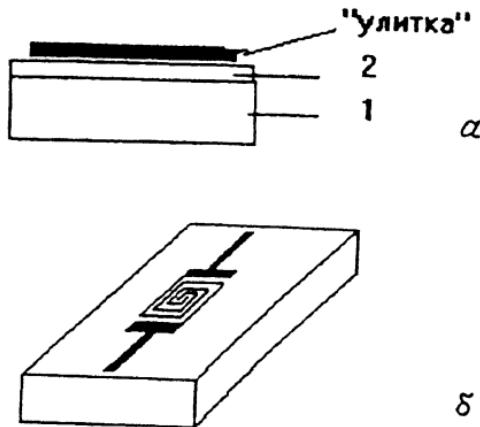


Рис. 1. Общий вид спиральной структуры металл-полупроводник-металл 1 — s.i.GaAs, 2 — n-GaAs.

разомкнутых частей. Каждая такая часть "улитки" соединяется с соответствующим электродом стандартной передающей линии.

Рассмотрим более подробно плоскую спираль — "улитку". Предполагая, что межвитковый зазор  $d$  постоянен и значительно меньше длины прямого отрезка витка, можно для расчета величины емкости воспользоваться формулой плоского конденсатора. При этом емкость  $C_{s1}$  участка спирали, образованного двумя прямыми отрезками ее витков  $l_1$  и  $l_2$  ( $l_1 > l_2$ ), будет пропорциональна длине меньшего проводника, т. е.  $C_{s1} \approx l_2$ . Тогда общая емкость спиральной структуры будет иметь вид

$$C_{sN} \approx (N/2 - 1)L - 4d \sum_{n=1}^{(N/2-1)} n, \quad (1)$$

$$C_{sN} \approx (N/2 - 1)(L - dN),$$

при  $N \gg 1$  и  $L = 4aN = 2dN$  следует, что

$$C_{\text{спр}} = C_{sN} \approx dN(N/2 - 1), \quad (2)$$

где  $L$  — апертура спирали,  $d$  — межвитковый зазор,  $a$  — полуширина отдельного витка,  $N$  — число витков.

Для сравнения емкость ординарной встречно-штыревой структуры пропорциональна  $(N - 1)(L - 2d)$ .

Отношение емкости спиральной  $C_{sN}$  и встречно-штыревой  $C_{sN}$  структур практически не зависит от числа витков  $N$  или от выбранной величины  $L/d$  и составляет величину, равную 0.25. Обозначим отношение этих емкостей как коэффициент  $k_1 = 0.25$ . Емкость встречно-штыревой структуры

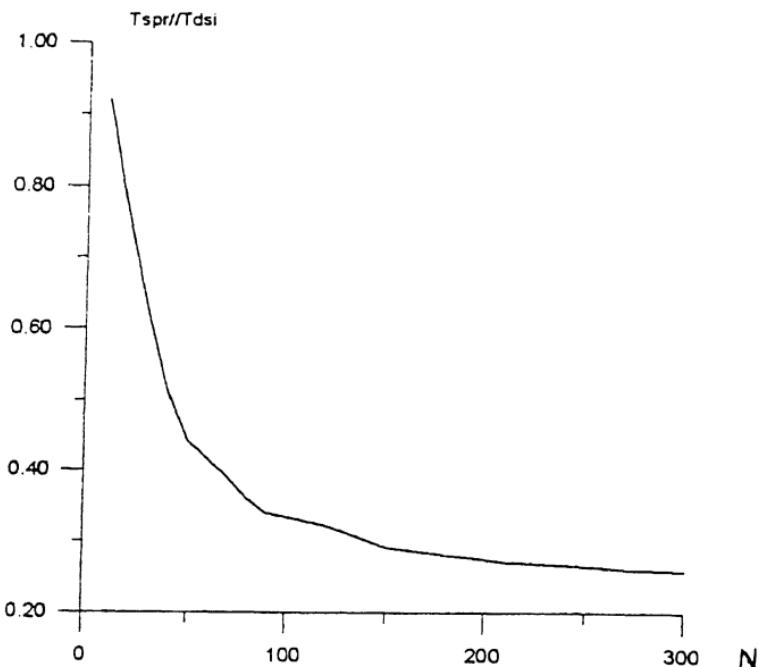


Рис. 2. Отношение времени отклика спиральной и встречно-штыревой структур.

определяется как [1]

$$C_L = \epsilon \epsilon_0 L^2 / 4d, \quad (3)$$

где  $L = 2a(N + 1) + dN$ ,  $\epsilon \epsilon_0$  — диэлектрическая проницаемость полупроводника. Полное время фотоотклика  $t_{tot}$  равно сумме пролетного времени  $t_r$  и времени схемной релаксации  $t_{RC}$  [4], т. е.

$$t_{tot} = t_r + t_{RC} = d/v_s + 2.2 R C_L, \quad (4)$$

где  $v_s$  — скорость насыщения полупроводника,  $R = 50 \Omega$  — нагрузочное сопротивление схемы включения фотодетектора. Считая, что  $2a = d$  и  $N \gg 1$ ,  $k_1 = 0.25$ , и с учетом (3) получим выражение для расчета полного времени отклика фотодетектора со спиральной структурой металл-полупроводник-металл. Это выражение примет вид

$$t_{tot} = (d/v_s)(1 + 110k_1\epsilon \epsilon_0 v_s N^2). \quad (5)$$

Зная, что полоса рабочих частот  $\Delta F$  фотодетектора связана с временем отклика  $t_{tot}$  соотношением [4]

$$\Delta F = 0.4/t_{tot},$$

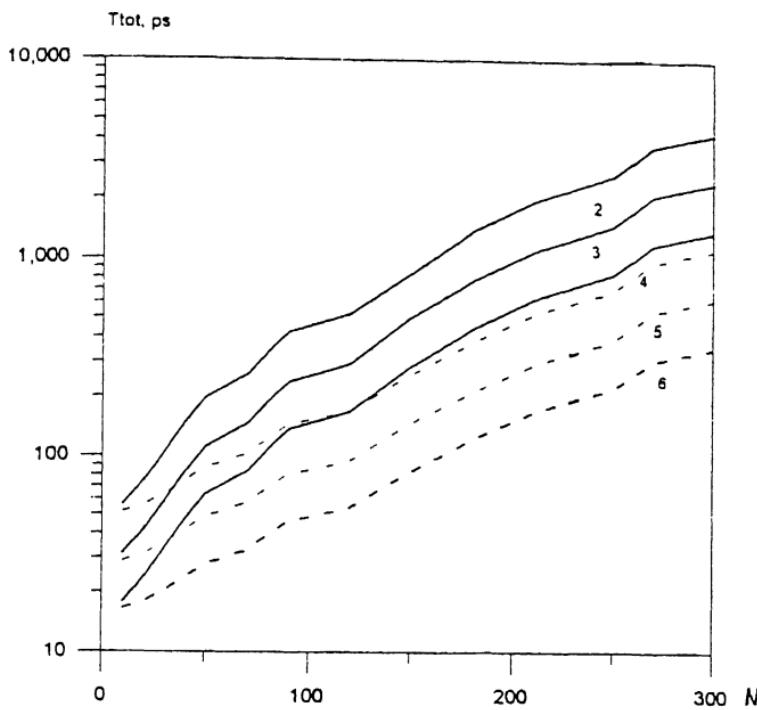


Рис. 3. Зависимость времени отклика спиральной и встречно-штыревой структур для  $d = 1.6 \text{ мкм}$ ,  $U = 3 \text{ В}$  (кривые 1, 4);  $d = 2.8 \text{ мкм}$ ,  $U = 7 \text{ В}$  (кривые 2, 5);  $d = 5 \text{ мкм}$ ,  $U = 10 \text{ В}$  (кривые 3, 6).

получим уравнение для расчета полосы рабочих частот фотодетектора со спиральной структурой электродов

$$\Delta F = 0.4(v_s/d)/(1 + 27.5\varepsilon\varepsilon_0 v_s N^2). \quad (6)$$

При этом считаем, что верхняя частота полосы соответствует такому значению, при котором мощность электрического сигнала на нагрузке  $50 \Omega$  уменьшается на  $3 \text{ дБ}$  по сравнению с ее максимальным значением.

На рис. 2 приведена рассчитанная с помощью (4)–(6) зависимость отношения времени отклика для спиральной и встречно-штыревой структур. На рис. 3 показаны зависимости времени отклика спиральной (кривые 1–3) и встречно-штыревой структур (кривые 4–6) от числа элементов  $N$  для трех значений межвиткового зазора  $d$  ( $1.6, 2.8$  и  $5 \text{ мкм}$ ). При этом предполагалось, что примесная концентрация  $n$ -типа арсенида галлия составляет  $5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ , а ширина области пространственного заряда при напряжении смещения  $3\text{--}10 \text{ В}$  равна ширине межвиткового зазора.

Из приведенных зависимостей следует, что спиральная структура обеспечивает выигрыш в быстродействии

по сравнению с встречно-штыревой структурой тем больше, чем больше ее апертура. Такое поведение отношения времен отклика спиральной и встречно-штыревой структур объясняется тем, что при малых апертурах время пролета  $t_r$  превышает время схемной релаксации  $t_{rc}$  и полный временной отклик системы  $t_{tot}$  определяется только временем пролета основных носителей  $t_r$ . По мере увеличения апертуры время схемной релаксации начинает расти и становится доминирующим при больших апертурах, т. е.  $t_{tot} \approx t_{rc}$ .

Таким образом, спиральные структуры обладают преимуществом по сравнению с встречно-штыревыми при широких апертурах приемной площадки фотодетектора.

### Список литературы

- [1] Slayman C.W., Figueira L. // Pat. Europ. N 0 063 422, 1982.
- [2] Roth W., Shumashier H., Kluge J. et al. // IEEE Trans. on Electr. Devices. 1985. V. ED-32. N 6. P. 1034-1036.
- [3] Osamu Wada // Optical and Quant. Electr. 1988. V. 20. P. 141-174.
- [4] Свечников Г.С. Элементы интегральной оптики. М.: Радио и связь, 1987. 103 с.
- [5] Ушаков Н.М. // Пат. России. №: 1 800 506. 1993.

Институт радиотехники  
и электроники РАН  
Саратовский филиал

Поступило в Редакцию  
22 апреля 1996 г.